



详情了解更多
请扫描官网二维码

先进电子集成及封装材料 应用解决方案

Material solutions for advanced packaging and integration

www.trumjin.com

 **湖南创瑾科技有限公司**
Hunan Trumjin Technology Co., Ltd

湖南省长沙市宁乡经开区谐园北路蓝月谷智能制造产业园五号楼

电话: +86-731-88691766 邮编: 410699

www.trumjin.com



匠心 / 创新 / 智慧 / 至美

湖南创瑾科技有限公司
Hunan Trumjin Technology Co., Ltd

关于创瑾

湖南创瑾科技有限公司成立于2018年1月，位于宁乡经济技术开发区谐园北路蓝月谷智能制造产业园。创瑾致力于提供商用显示、先进材料解决方案，是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。

公司注册资金2000万元，项目总投资3.3亿元，建筑面积约1.2万平方米，研发人员50人左右。公司拥有千级、百级等无尘车间，配套研发中心、测试中心、实验室，引进行业内最先进的生产设备及进口检测仪器。中、美工程院院士领衔，孵化中科院及国内各大高校科研成果，公司技术力量雄厚。

创瑾秉承“匠心、创新、智慧、至美”的品牌理念，将持续加大研发投入，努力以创新提升价值，给客户提供更好的产品和服务。

— 智能硬件、先进材料 提供商

50+

科技研发人员50人左右

12,000 m²

建筑面积约1.2万平方米

33,000 万元

工业园项目总投资33000万元



可靠性实验室



净化生产车间



公司外景



专利与荣誉墙



团队介绍

Hanlicon品牌创立于2018年，隶属创瑾科技集团，专注于提供用于半导体集成及封装，新能源储能，高频高速通讯，微电子器件组装和通用工业的先进材料和工艺的整套解决方案。

生产制造

公司致力于打造专业和现代化的工厂，厂房面积超4000平方，拥有先进化学实验室，物理实验室，产品应用及测试实验室，以满足客户对产品验证，品质管控和交付能力等各方面要求。

4,000 M²

实验室厂房超四千平方米



半导体封装



新能源储能



微电子组装

研发技术

由康奈尔大学博士，IEEE Fellow，Dr.Wei Koh领衔组建，由一批国际高精尖博士，硕士及资深材料研发团队和应用测试团队组成，同时与国内外高校战略合作人才培养和项目开发，国内新材料研究机构和单位，共同打造国内先进材料应用提供商。公司创立至今已取得多项产品发明及实用专利，填补国内部分空白。

市场销售

公司拥有一批专业的销售和客户服务团队，并构建全球范围销售和服务网络，可提供在线及现场专业服务，针对客户应用需求提供一站式解决方案。



先进电子集成
及封装材料
应用解决方案

Material solutions
for advanced packaging
and integration

目录 CATALOG

第1篇：电子组装材料

导电银胶	05
环氧-导热灌封胶	06
有机硅-导热/灌封材料	07
底部填充材料	08
UV固化胶粘剂	09
低温固化环氧结构粘接胶	10
PUR热熔结构粘接胶	11
双组份丙烯酸结构粘接胶	12
有机硅胶粘剂	13
瞬干胶	14
可剥防焊胶	15
保护胶	15
三防涂层	16

第2篇：行业应用解决方案

摄像模组用胶	17
指纹模组用胶	19
LCD模组用胶	21
TP/全贴合应用	22



导电银胶



性能卓越 | 品质稳定 | 高效可靠

产品简介

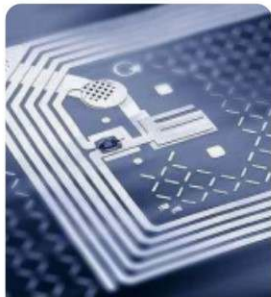
Halicon环氧导电银浆适用于电子元件的导电连接等用途。本产品拥有优良的导电性、附着力，耐弯折性和易印刷性，具有稳定的触变性，适用于各种工艺。

H2151

- 对基材有优良的附着力
- 导电性优秀
- 稳定性优秀
- 特别适用于印刷工艺

产品应用

存储卡、摄像头模组、指纹识别等各类电子元器件的导电性连接。



H2157

- 稳定的触变性
- 固化温度低，固化速度快
- 优异的导电性、可靠性

型号	化学类别	颜色	密度(g/ml)	粘度@25°C(cps)	体积电阻率(Ω.cm)	固化条件	保质期@0~10°C(Months)
H2151	改性环氧	银色	2.5	20000	1×10^{-4}	50min@180°C	6
H2157	环氧	银色	3.5	14000	1×10^{-4}	30min@120°C	6

环氧-导热灌封胶

产品简介

Halicon环氧系列的导热胶是一种可低温快速固化的导热灌封材料，混合后粘度低，利于操作，同时具备一定的热导率。用于热扩散和抗热震性有要求的组件封装。

H2082 (A/B)

- 可室温或低温固化
- 对金属具有良好的粘接性
- 良好的间隙填充能力
- 耐冷热冲击性（-40~150℃）
- 符合UL94 HB阻燃等级

产品应用

电动机定子、变压器线圈、传动装置，高温发电机组5G电源等通用导热粘接灌封。

H2132

- 低温固化
- 高导热率
- 粘接强度高
- 耐高温高湿，冷热冲击好



型号	化学类别	颜色/配比	粘度@25°C(cps)	硬度(shore)	导热率(w/m.k)	固化条件	保质期@25°C(Months)
H2082	环氧	A: 黑色 B: 淡黄 (质量 A:B=6:1)	A:25000~45000 B:45~80	85D	1	50min@180°C	12
H2132	环氧	黑色	170000	90D	2.5	30min@120°C	12

有机硅- 导热/灌封材料

产品简介

Halicon有机硅系列导热界面材料具备低热阻，低应力，高导热率，对材料表面具有良好的浸润效果，为发热量大的元器件提供高效的散热解决方案和长期稳定的可靠性。

H6140 (A/B)

- 高导热性能
- 触变性
- 超低压缩力，可替代热润滑脂
- 低硅油渗出率
- 长期可靠性
- 符合 RoHS

产品应用

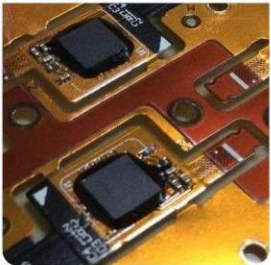
各类电子器件、新能源汽车电池、汽车逆变模块、5G通讯模块、高频变压器等有绝缘耐温和散热要求的电子器件和散热片/器的粘接，灌封，防水防潮抗振动保护。

H6135

- 高导热性能
- 触变性
- 超低应力
- 低析油率
- 稳定的可靠性
- 符合 UL94V-0

H6125 (A/B)

- 高导热率
- 触变性，易于操作
- 良好的电气绝缘性
- 耐高低温冲击，耐候性佳
- 符合RoHS



型号	化学类别	颜色/配比	粘度@25°C(cps)	硬度(shore)	导热率(w/m.k)	固化条件	保质期@5-25°C(Months)
H6140	有机硅	A: 蓝色 B: 白色 (质量 A:B=1:1)	Paste	32 (00)	4	24hrs@25°C	9
H6135	有机硅	灰色	Paste	<15 (00)	3.5	48hrs@25°C	9
H6125	有机硅	A: 黄色 B: 白色 (质量 A:B=1:1)	Paste	60 (00)	2.5	15hrs@25°C	9



底部 填充材料

性能卓越 | 品质稳定 | 高效可靠

产品简介

Halicon单组分加热固化环氧填充灌封材料，具备坚固的封装效果，极低的膨胀系数，以及优秀的耐湿气耐老化性能。

H2105

- 低 CTE; 高Tg值，耐温性好
- 低卤环保，可返修
- 室温快速流动
- 中温快速固化
- 与大多数助焊剂残留物兼容性好
- 优异的可靠性

产品应用

主要用于 CSP 或 BGA 底部填充，对芯片进行补强等提高产品的可靠性。

H2110

- 低卤环保
- 室温下流动性好
- 电气性能佳

H2113

- 低 CTE, 低Tg, 易返修
- 低卤环保
- 室温流动性佳
- 中温快速固化，与大多数助焊剂残留物兼容性好
- 优异的可靠性



型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	Tg(°C)	CTE1(ppm/°C)	固化条件	保质期@-20°C(Months)
H2105	环氧	黑色	400	115	165	30min@110°C	9
H2110	环氧	黑色	400	110	200	10min@130°C	9
H2113	环氧	黑色	360	73	171	30min@110°C	9



UV固化胶粘剂

产品简介

Halicon系列UV胶具备快速固化，粘接力强，环保，操作简易，柔韧性好，抗振动和抗冲击等优点。通常用于PC、PMMA、玻纤、玻璃等透明材料的自粘或者和金属，陶瓷等材料的粘接。同时具备密封，防潮、绝缘、保护与固定的作用。

产品应用

适合用于基础的粘接、密封、固定，广泛应用于电子电器、光学仪器、医疗器具、玻璃制品、珠宝业制造等领域



H5056

- 固化快
- 无溶剂
- 氧阻聚作用极小
- 柔韧性佳
- 适用于不同材料之间的粘接

H5056H

- 强度高
- 固化快
- 无溶剂
- 柔韧性佳
- 适用于不同材料之间的粘接

H5221

- 高触变性
- 高强度
- 附着性好
- 柔韧性佳
- 对电子产品兼容性好

H5224

- 可填充大间隙
- 触变性粘度
- 高强度
- 附着性好

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	硬度(shore)	拉伸强度(Mpa)	固化条件(@365nm)	保质期@5-28°C(Months)
H5224	改性丙烯酸	半透明	18000-35000	90A	13	70mW/cm²*60s	12
H5056	丙烯酸	无色透明	600-2700	50A	3.6	400mW/cm²*20s	12
H5056D	丙烯酸	蓝色	600-2700	52A	3.2	400mW/cm²*20s	12
H5056H	丙烯酸	无色透明	600-2700	64A	11.5	400mW/cm²*20s	12
H5221	改性丙烯酸	无色透明	4200-7800	73A	7.5	100mW/cm²*20s	12

低温固化环氧结构粘接胶

产品简介

Halicon环氧结构胶具有很高的机械强度，极小的热膨胀系数，对大多数金属，玻璃，陶瓷，塑料等基材都有很强的粘接力。

产品应用

能够应对各种材料的粘接，低温固化，低膨胀系数更适用于摄像头模组，图像传感器，指纹传感器，触摸面板，LED背板等精密组件的组装。

H2122

- 单组分，触变性
- 高粘度
- 低温固化
- 耐高温
- 低膨胀系数
- 适用于高精度点胶

H2122B

- 单组分，触变性
- 中等粘度
- 低温固化
- 耐高温
- 低膨胀系数
- 适用于高精度点胶

H2122W

- 单组分，触变性
- 低粘度
- 低温固化
- 耐高温
- 低膨胀系数
- 适用于高精度点胶



型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	硬度(shore)	剪切强度(Mpa)	固化条件	保质期@-20°C(Months)
H2122	环氧	黑色	21000	88D	10	30min@80°C	9
H2122B	环氧	黑色	12000	86D	13	30min@80°C	9
H2122W	环氧	白色	8700	80D	15	30min@80°C	9



PUR热熔 结构粘接胶



产品简介

Halicon热熔胶产品基于聚氨酯预聚物的反应型热熔粘合剂，材料在粘接初始就能够有很高的初粘强度，完全固化后能够抵抗高温，具备防潮耐湿，耐冲击，耐候等高性能和长期可靠性。

产品应用

适用于各种边框组件，TP触摸屏与外壳，电池外壳等结构性粘接。



H3007

- 单组份反应型
- 快速固化
- 高粘接强度
- 韧性极好
- 高抗冲击性

H3008

- 单组份,无溶剂
- 粘接力强, 适应大部分基材
- 抗冲击性能优异
- 良好的防潮性能
- 优异的化学性能和电气性能

H3009

- 单组份,无溶剂
- 初粘力强
- 固化速度快
- 非常好的粘结强度和抗冲击性能
- 适应大多数基材

型号	化学类别	颜色	粘度@110°C(cps)	开放时间(min)	剪切强度(Mpa)	固化条件@25°C/RH50%(h)	保质期@9-25°C(Months)
H3007	聚氨酯	黑色	12000	≥2	≥5	24	9
H3008	聚氨酯	半透明/黑色	4500-6500	2-4	9	24	9
H3009	聚氨酯	白色	7500-10500	4	≥3	24	9

双组份丙烯酸 结构粘接胶

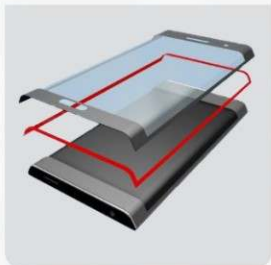


产品简介

Halicon双组份丙烯酸结构胶具有快速定位的固化效果，并且对金属，塑料，复合材料等多种基材粘接性优良，同时也具有很高的延伸率和剥离强度，固化后具有优异的耐冲击，抗疲劳耐震动等性能。

产品应用

适用于各种工业领域塑胶或金属部件的结构性粘接，例如作为电气，元器件等外框的结构粘接。



H5001

- 室温快速固化
- 基本不需要表面预处理
- 优异的冲击强度和剥离强度
- 优良的耐候性
- 符合无卤标准

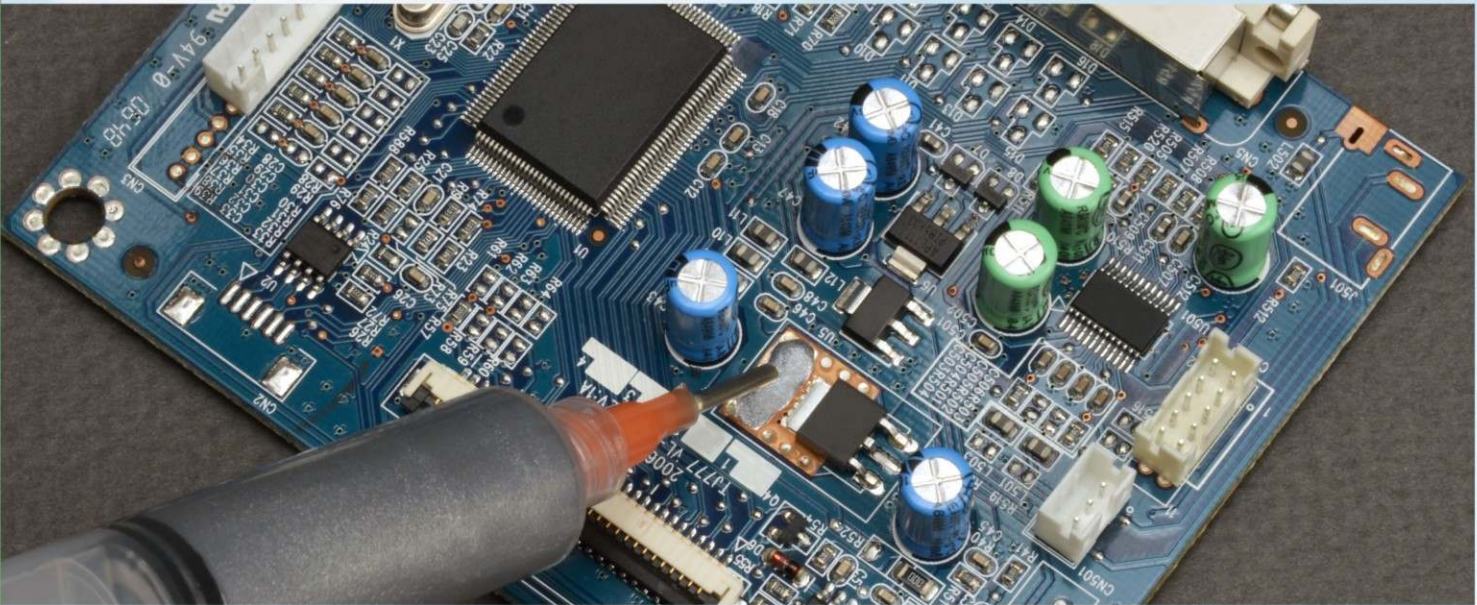
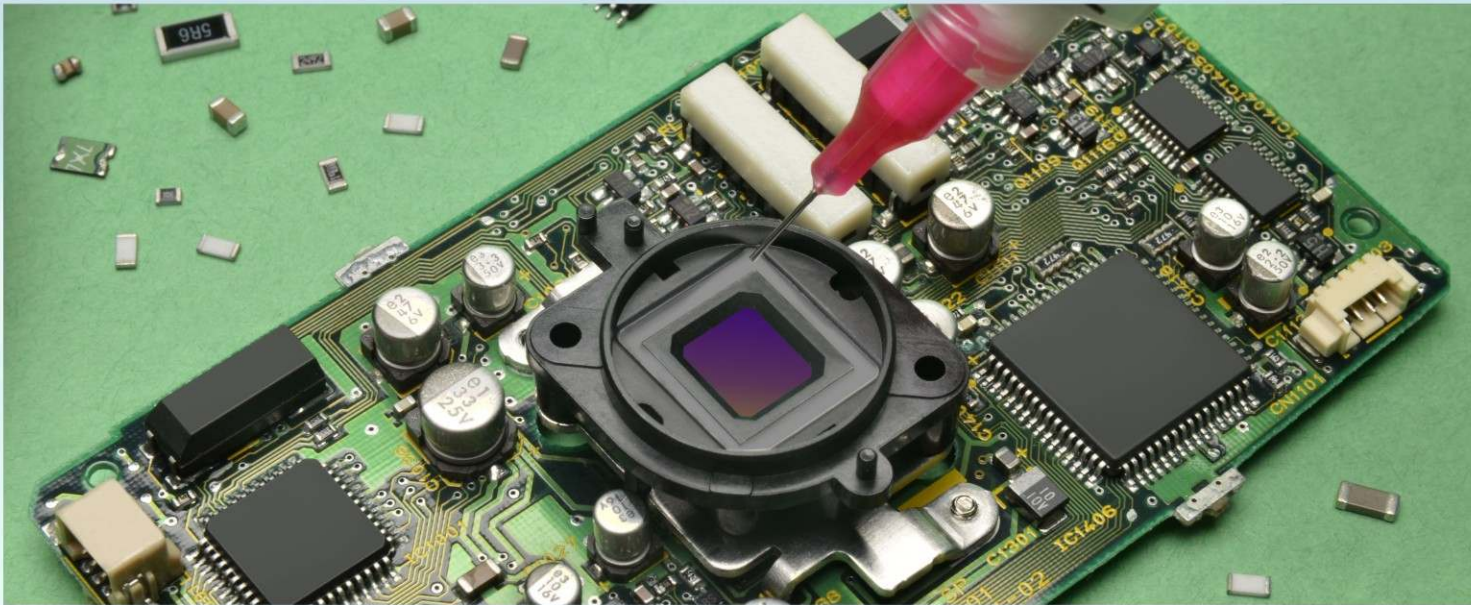
H5002

- 高粘度、高触变、不垂流
- 无需表面处理
- 韧性好,抗冲击性好, 耐疲劳
- 固化快,30分钟达到最终强度的75%
- 适合大间隙粘接

H5013

- 室温固化
- 固化快,粘接定位时间短
- 优异的粘结力
- 抗冲击性能优秀
- 抗老化、耐溶剂性好

型号	化学类别	颜色/配比	粘度@25°C(cps)	操作时间(min)	剪切强度Al/Al(Mpa)	固化条件@25°C(h)	保质期@25°C(Months)
H5001	丙烯酸	A: 琥珀色 B: 蓝色 (体积 A:B=10:1)	A:40000 B:20000	6	19	24	12
H5002	丙烯酸	A: 白色 B: 蓝色 (体积 A:B=10:1)	A:50000 B:150000	3	15	24	12
H5013	丙烯酸	A: 黑色 B: 黑色 (体积 A:B=1:1)	A:40000-60000 B:20000-40000	8	16	24	12



有机硅胶粘剂

产品简介

Halicon有机硅系列粘接密封胶，具有极好的绝缘性，耐压强度，耐高温性能，能够抵抗恶劣的环境，对基体进行长期可靠的保护。

产品应用

适用于光学元件，电子元件的粘接，太阳能模组边框密封，汽车部件组装等



H6311

- 中性,脱乙醇型,气味低
- 阻燃型
- 挤出率好,粘接性能好
- 抗冷热交变、耐老化
- 电绝缘性能优秀
- 符合 ROHS

H6312

- 中性,脱醇,低气味
- 对金属材料无腐蚀
- 粘接性强,柔韧性高
- 电气性能佳
- 耐温优异(-50~200℃)
- 符合 ROHS

H6315

- 中性,脱醇,低气味
- 对金属材料无腐蚀
- 电气性能佳
- 耐温优异(-50~200℃)
- 通过UL94V-0认证
- 有一定的导热效果

型号	化学类别	颜色/配比	粘度@25°C(cps)	硬度(shore)	体积电阻率Ω.cm	固化条件(°C*min)	保质期@25°C(Months)
H6311	有机硅	白色	Paste	70A	1.0×10^{14}	48 hrs @ 23°C	12
H6312	有机硅	白/灰/黑色	Paste	40A	5.0×10^{14}	48 hrs @ 23°C	12
H6315	有机硅	白色	Paste	50A	6.5×10^{13}	48 hrs @ 23°C	12

瞬干胶

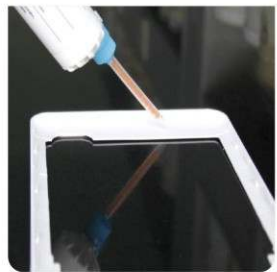
产品简介

Halicon瞬干胶是一种单组份无溶剂，快速固化，氰基丙烯酸酯胶粘剂。该产品特别适合于难粘基材的粘接。与其它标准级氰基丙烯酸酯胶粘剂相比，本产品的固化速度较小依赖于基材表面的水分。



产品应用

适用于大多数金属，塑料或弹性材料的粘接，尤其适合于粘接多孔或吸收材料，例如木材纸，皮革或织物。



H5311

- 通用型
- 快速粘接
- 耐高温
- 优秀的电气性能
- 耐化学介质

H5320

- 快速粘接
- 低气味
- 低白化
- 适用于多种基材的粘接

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	定位时间(s)	剪切强度Al/Al(Mpa)	固化条件@25°C/RH50%(s)	保质期@5-28°C(Months)
H5311	氰基丙烯酸酯	无色透明	110	2-10	15	30-90	12
H5320	氰基丙烯酸酯	无色透明	40	2-10	10	30-90	12



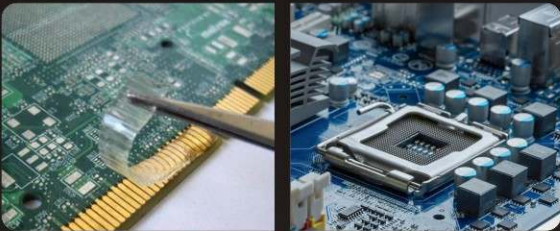
可剥防焊胶

H1113

- 快速固化
- 易于剥离
- 不沾污金和磷铜
- 耐高温，保护易损元件
- 不易燃

产品应用

接头、螺丝孔、通孔的焊接保护。



型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	PH	耐温℃	固化条件	保质期@10-25°C(Months)
H1113	乳胶	白色	9000-13000	11	260	45min@25°C	6

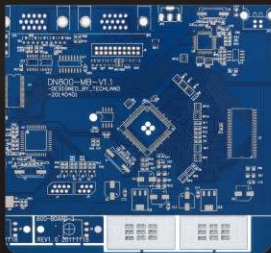
保护胶

产品简介

Halicon保护胶体是一种固化后能形成一定强度的弹性高分子膜层，对电子组装过程能够起到临时性的保护作用，有一定的粘附性又方便剥离。

产品应用

LCM液晶显示模组,ITO端口的防污绝缘保护,电路板涂覆保护及精密微电子元器件涂覆密封。



H3211

- 中性，对基材无腐蚀
- 不含三苯与芳烃
- 附着性好，可剥离
- 符合RHOS

H3255

- 高粘度
- 加热快速固化
- 附着性好，可剥离

型号	化学类别	颜色	密度(g/ml)	粘度@25°C(cps)	硬度(邵氏A)	固化条件	保质期@10-25°C(Months)
H3211	丙烯酸	蓝色透明	0.82	300	20	45min@25°C	6
H3255	丙烯酸	蓝色膏状	1.1	23000-27000	25	20min@130°C	6

三防涂层

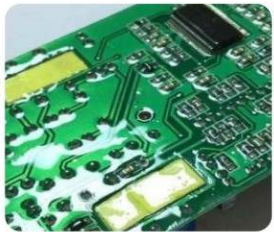


产品简介

Halicon防护涂层能够应对PCB制造工艺过程的高温，化学溶剂以及成品件在不同工况下可能面对的高温高湿，机械冲击，水气粉尘等会造成电子元件损害的因素，对各种精密电子元器件进行有效的保护。

产品应用

广泛应用于电子组装，电路板涂覆保护及精密微电子元器件涂覆密封，如LCM液晶显示模组，ITO端口的防污绝缘保护等。



H3210

热固型改性丙烯酸三防除层

- 高透，高光泽，高丰满度
- 附着力佳
- 电气性能优秀
- 防潮，防尘

H3213

UV+湿气双固化三防涂层

- 环保，无溶剂
- UV快速固化
- 阴影区湿气固化
- 优秀的电气绝缘性能
- 耐湿气，耐腐蚀

H5162

溶剂型醇酸三防除层

- 环保，无三苯，芳香烃化合物
- 粘度低，适用多种施胶工艺，符合RHOS
- 附着力好，耐热老化130°C
- 含蓝色荧光紫外线指示剂，便于检查涂层
- 优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕

H6013

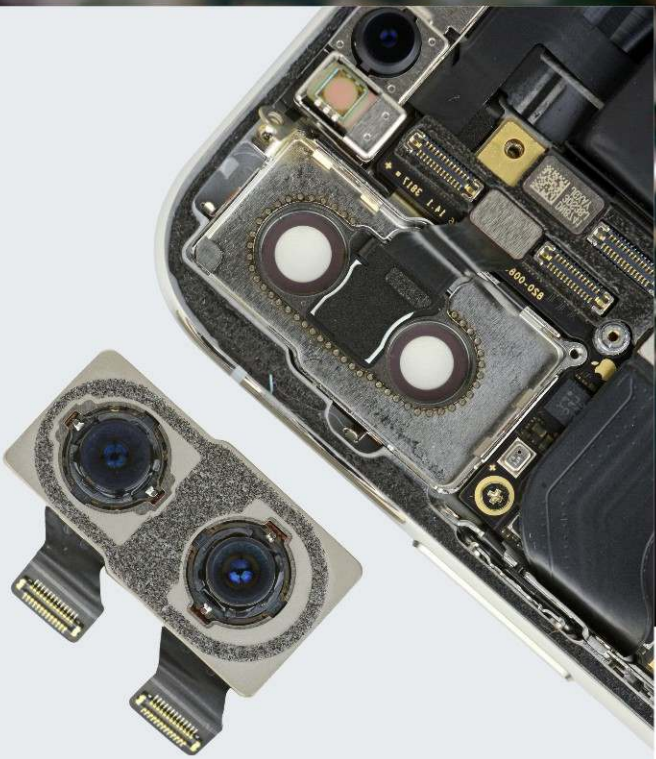
高性能电子涂覆胶

- 单组份室温固化
- 对金属基材无腐蚀
- 优秀的电气绝缘性能
- 涂层可剥易返修
- 无卤，符合RHOS

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	硬度(Shore)	体积电阻率(Ω.cm)	固化条件	保质期@25°C(Months)
H3210	改性丙烯酸	无色透明	60	50D	2.0×10^{16}	1h@50°C	12
H3213	丙烯酸	淡黄色透明	250	75D	3.0×10^{16}	UV+湿气	12
H5162	改性醇酸树脂	淡黄色透明	50	25A	1.3×10^{15}	室温24h	12
H6013	有机硅	深蓝透明	300~500	20A	1.9×10^{13}	室温24h	12



摄像模组用胶

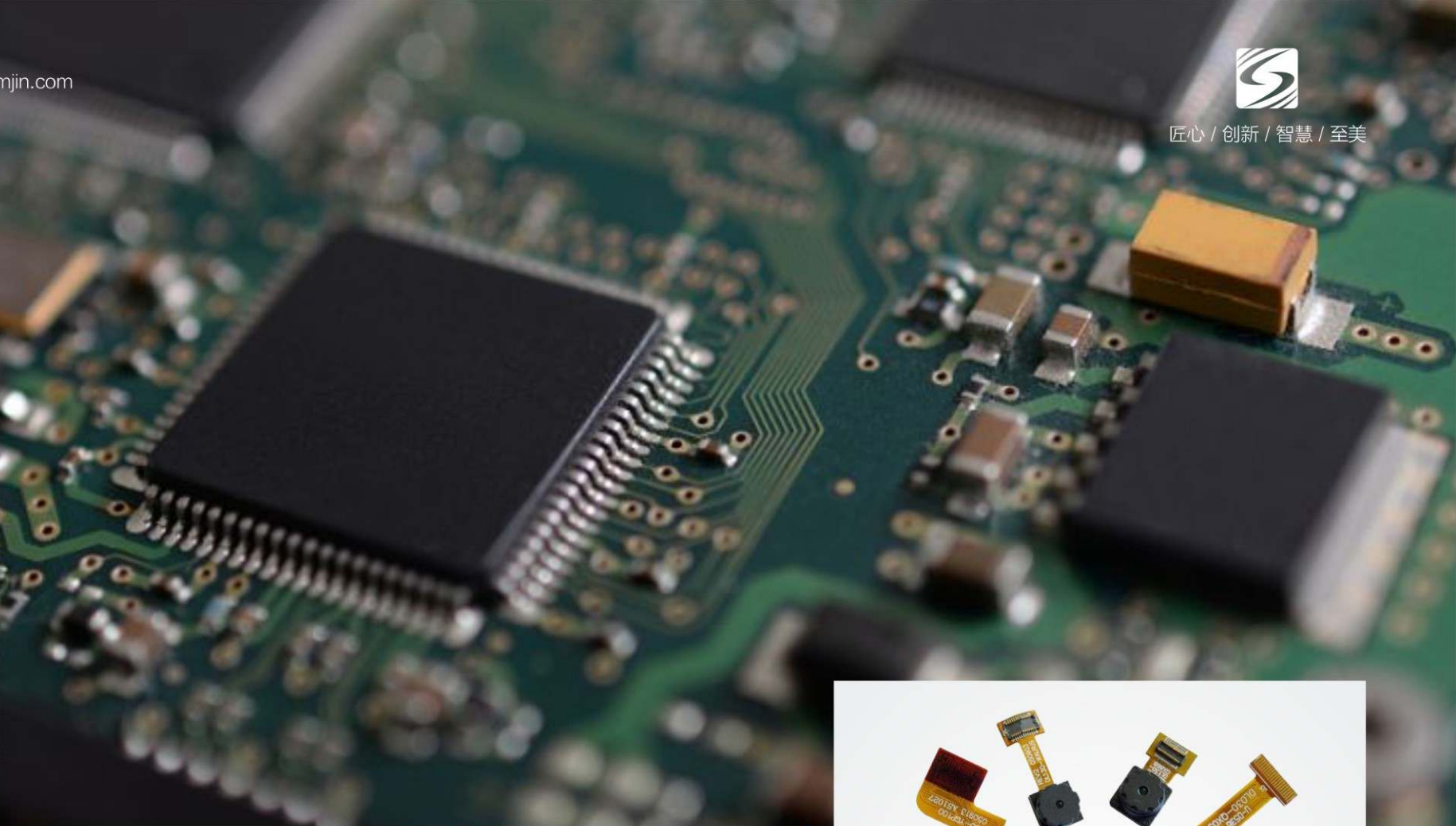


芯片粘接

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	固化条件	应用特性
H2122	环氧	黑色	21000	30min@80℃	单组份，不导电，低温快固

Hold固定

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	固化条件	应用特性
H2122B	环氧	黑色	12000	30min@80℃	触变性粘度，低温固化，低膨胀系数 耐高温，适合高精度点胶
H2110W	环氧	白色	8700	30min@80℃	触变性粘度，低温固化，低膨胀系数 耐高温，适合高精度点胶

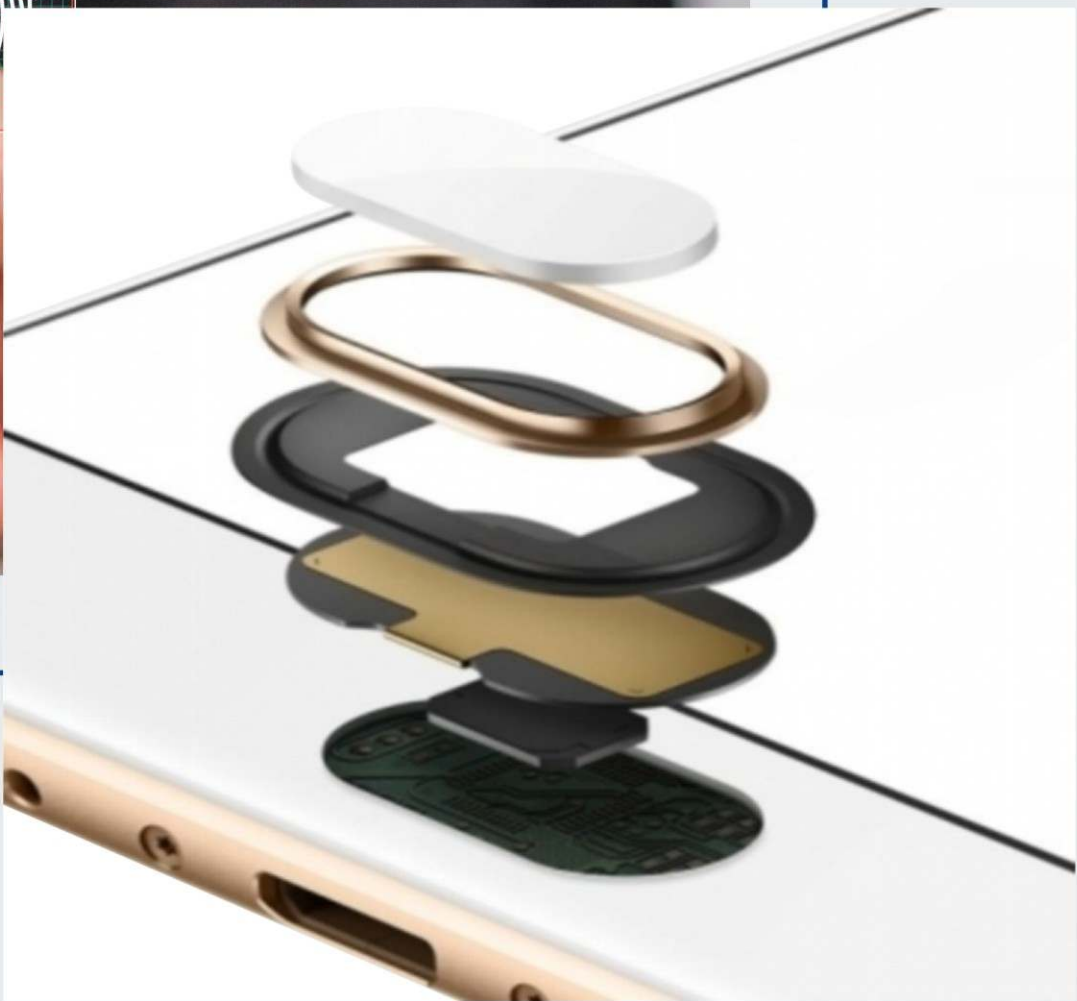


LENS固定

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	固化条件(@365nm)	应用特性
5224	改性丙烯酸	白色	18000~35000	70mW/cm²*60s	快速固化，触变性，高强度，抗冲击性优秀
5056	改性丙烯酸	无色透明	1250	400mW/cm²*20s	单组份，快固，柔韧性很好
5221	改性丙烯酸	无色透明	5000	100mW/cm²*20s	粘接力强，弹性模量好



指纹模组用胶



芯片粘接

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	固化条件	应用特性
H2122	环氧	黑色	21000	30min@80℃	单组份，不导电，低温快固

导电胶

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	固化条件	应用特性
2151	改性环氧	银色	20000	50min@180℃	优秀的电性、附着力 耐弯折性和易印刷性
2157	环氧	银色	14000	30min@120℃	低温快固，触变性粘度 适用于高速点胶

结构粘接

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	固化条件	应用特性
H2122B	环氧	黑色	12000	30min@80℃	触变性粘度，低温固化，低膨胀系数 耐高温，适合高精度点胶
H2110W	环氧	白色	8700	30min@80℃	触变性粘度，低温固化，低膨胀系数 耐高温，适合高精度点胶

底部填充

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	固化条件	应用特性
2110	环氧	黑色	400	10min@130℃	CSP或BGA底部填充 对芯片进行补强
2113	环氧	黑色	360	30min@110℃	电气性能好，低膨胀系数 可重工

LCD模组用胶



模组用胶

型号	化学类别	颜色	粘度@25°C(cps)	固化条件	应用特性
3211	丙烯酸	蓝色透明	300	45min@25°C	液晶显示模组 ITO端口的防污绝缘保护
3255	丙烯酸	蓝色膏状	23000-27000	20min@150°C	LCD保护胶



TP/全贴合应用



光学贴合

型号	化学类别	颜色/配比	粘度@25°C(cps)	固化条件	应用特性
6080	有机硅	A:无色透明 B:无色透明 (质量 A:B= 1:1)	A:600 B:850	30min@60°C	透光率高, 柔韧性佳, 抗冷热冲击, 耐候性优秀, 自修复性
5196	丙烯酸	无色透明	3200-4200	UV固化	快速固化, 粘接性好, 透光率高